௵Int.Cl. 62日本分類 日本国特許庁

印特許出願公告 昭46-43172

H 01 1 H 01 g

99(5) H 0

99(5) G

59 E 101.24

❷公告 昭和 46 年(1971)12月 21 日

発明の数 5

(全5頁)

1

図高周波半導体コンデンサ

0)特 顧 昭44-39093

经出 頭 昭44 (1969) 5月20日

カ国の754321

70発明者 ラム・ショール・ローゼンプラム

アメリカ合衆国ニユージャージ州 ニュー・プランスウイツクチエス

タ・サークル81

初出 顧 人 アール・シーエー・コーポレーシ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 クフエラープラザ30

代 理 人 弁理士 清水哲 外1名

図面の簡単な説明

. [

10

H

第1図はこの発明のコンデンサの一実施例の平 面図である。第2図は第1図の線2-2に沿り拡 20 比抵抗は非常に低くすべきである。 大断面図である。第3図は第1図の線3-3に沿 う断面図である。第4図は第1図の線4-4に沿 **り断面図である。第5図はとの発明のコンデンサ** の他の実施例の断面図である。第6図は従来法の コンデンサの等価電気回路図である。第7図はと 25 ツク材料等とすることができる。 の発明のコンデンサの等価電気回路図である。 発明の詳細な説明

との発明は平行平板コンデンサに関し、特に少 くとも一方の極板は半導体物質で構成された、集 **着回路用に流したコンデンサに関する。**

半導体基体の表面に絶縁層を設け、さらにその 上に金属板を設けたコンデンサは公知である。電 極は絶縁層の横の位置でその半導体基体の表面と 接触している。とのようなコンデンサに伴なう問 題点はそれが高周波で動作しなくなることである。35 こともできる。適当な酸化物の被膜は例えばシラ これは高い周波数ではコンデンサの複素インピー ダンスの実数部分、すなわち抵抗値が主として効 いてくるからである。この効果は半導体物質の厚

2

さが薄いコンデンサでは非常に著しい。

この発明による半導体コンデンサは、半導体物 質の基体と、この基体上の絶縁物質層と、上記半 導体物質に接触する電極と、上記絶縁物質の上の 優先権主張 201968年8月21日30アメリ 5 極板とからなり、上記電極が上記半導体物質と接 触した複数個の平行な指状突起を有し、かつ上記 極板が上記絶縁物質上に配置された複数個の平行 な指状突起を有し、さらに上記電極の指状突起が 上記極板の指状突起と相互に入り組んで配置され 10 ていることを特徴とする。

> 第1図において、10で示されたこのコンデン サの一実施例は表面13に半導体層12を有する 絶縁基体11を含む。基体11は単結晶物質とし、 第2図のように半導体層12をその上にエピタキ 15 シャル法で形成されることが好ましい。例えば、 基体はサファイアとし、その表面13をそのサフ アイアの(1102)面に平行とする。半導体層はサ フアイアの(1102)表面に(100)軸の方向にエビ タキシャル成長した珪素とする。また、層12の

層12はエピタキシャル法以外の方法でも形成 することができる。例えば、その半導体物質は基 体11上に被着されたセレン化カドミウムのよう な物質でもよく、との場合には基体11はセラミ

半導体層12は表面13の一部分だけを覆い、 第1図の平面図では矩形を呈する。半導体層12 の形状は例えば通常の写真製版法を用いて形成す ることができる。

半導体層12上には任意の方法で形成された絶 縁物質の層14がある。それは水蒸気のような酸 化雰囲気中で半導体物質を加熱するととによつて 半導体物質の原始酸化物として形成することがで きる。層14は成長酸化物とする代りに被離する ンSiH 、および酸素 O2を含む雰囲気中で半導体 物質を加熱するととによって行なわれる表面化学 反応により得ることができる。絶縁層14は第1

図の櫛歯状金属パタン17の複数個の指状突起が 位置する一連の間隙15を有する。指状突起16 は半導体層12とオーム接触をしており、従つて パタン17は一方の電極を構成している。絶縁層 14の表面には極板を構成する櫛歯状パタン19 の複数個の指状突起18が配置されている。指状 突起16と18とは交互に指を組んだよりに配置 されている。

金属パタン17は基体11の表面に配置された 棒状部分20を含み、これから直角方向に指状突 10 ンデンサの電流方向の長さが長くなるほど、実効 起16が間隙15内の半導体層と接触して延びて いる。パタン19もまた棒状部分22を含み、と れから指状突起18が直角に延びている。極板バ タン19は金属、または高い導電性の気相沈着半 導体のような金属以外の物質とすることができる。15

パタン17と19とは、通常の写真製版工程に 適当な物質で基体11と半導電性絶縁物質とを被 優し、次に所要パタン以外の領域の物質をエッチ ングして除くことによつて形成することができる。 パタン17と19とはまた有孔マスクを通して物 20 質を沈着することによつても形成することができ る。珪素の量を制限し、各パタン17と19との 一部分をサフアイア基体の上に直接配置すると、 完全な直流絶縁と、同じ基体上に作ることができ 高い交流絶縁とが与えられる。交流絶縁は高周波 では非常に重要である。

第5図はこの発明のコンデンサの第2の実施例 を示す。とのコンデンサは1つの導電型、例えば P型の拡散領域を有する逆導電型、例えばN型の 30 珪素のような半導体物質のプロック24を含む。

半導体プロック24の上には第1図の実施例の 層14の形成に用いられる方法と同様の方法で絶 **緑物質の暦28が形成されている。この絶縁層** 28には一連の間隙30があり、この中に第1図 35 ビーダンス($Z=R+1/_{iwc}$)の虚数部は高い周 の実施例の櫛歯状図形17に似た電極構体(図示 せず)の複数個の指状突起32が配置されている。 絶縁層28の上表面には第1図の実施例の図形 19に似た極板構体(図示せず)の複数個の指状 **突起33が配置されている。**

第6図は前記の典型的な従来法のコンデンサの 電気的等価回路を示す。半導電性極板の分布抵抗 は直列抵抗36によつて示されている。コンデン サ極板38は各抵抗36に関連した半導体層のコ

ンサの金属極板を示す。端子42はそのコンデン サを外部回路網に接続するためのものである。抵 抗47は一方の端子42とその回路の残部との間 にあり、その大きさは半導体の表面の接触電極の、 5 金属極板に隣接して存在する半導体の部分から横 方向へ移動した距離の関数である。

他のコンデンサでは、半導体物質の抵抗である そのコンデンサの実効抵抗は入力電極からの距離 が遠くなると共化次第に大きくなる。従つて、コ 抵抗は大きくなる。これは次の関係式で明らかで

$$\mathbf{R} = \frac{\delta \mathbf{L}}{\mathbf{T} \mathbf{W}}$$

ここで δ = 半導体物質の比抵抗 $(\Omega - cm)$

上≔長さ

T=厚さ

W=個

上記コンデンサの抵抗、すなわち入力接触部と 実際のコンデンサ領域との間の抵抗 4 7 の一部分 はその入力接触部と実際のコンデンサ領域との間 隔を短くすることにより減少することができる。 るこのコンデンサと他の回路索子との間の非常に 25 しかしながらこの抵抗 47 には実質的な下限があ る。この限界は上極板と半導体物質への接触部と の間に可能な(写真製版その他の技術による)最 小距離が存在するという事実による。これは上記 の式のLの値に下限を与える。

> 直列抵抗47とコンデンサの半導体極板の抵抗 36とにより、従来法のコンデンサの遠隔領域の 電荷が入力端子の電圧の急激な変化に影響される **ことが防がれる。感度は抵抗値が距離と共に増加** する故に入力点からの距離と共に悪くなる。イン 波数で小さくなるので、高周波数では上記コンデ ンサの抵抗成分が支配的になる。

第7図はこの発明のコンデンサの電気的等価回 路を示す。半導体層の抵抗は電極17の形状のた 40 めに互いに電気的に並列になつている抵抗 4 6 に よつて示されている。コンデンサの極板48は各 抵抗46と関連する半導体層の容量部分を表わす。 極板50はこの装置の極板の指状突起18または 33を表わす。 とのコンデンサの半導体物質の分 ンデンサ部分を示す。極板40は従来法のコンデ 45 布内部抵抗は並列関係にあるために、その実効抵

板が上記絶縁層の上に配置された複数個の平行な 指状突起を含み、上記電極の指状突起が上記極板 の指状突起と交互に入り組んでいることを特徴と する半導体コンデンサ。

抗は非常に低い。また従来法の回路の抵抗47に 似た入力抵抗52がある。との装置の形状から、 上記抵抗もその幅がその長さと幅との比の減少と 共に実効的に増加するため実効的に減る。交互に ると、Wが増加し、Lが減少し、その両方とも上 記の式で明らかなように実効直列抵抗をかなり波 少させる。

組み合つた指状突起の単位面積当りの数を増加す 5 2 上記半導体本体は、エピタキシャル成長を可 能とする基体上にエピタキシャル成長した単結晶 の薄層より成るととを特徴とする特許請求の範囲 第1項の半導体コンデンサ。

とれらの考察はすべてとの発明のコンデンサの き、その結果とのコンデンサは入力点で変化する 高い周波数に応答するととができる。従つて、従 来法によるいかなるものよりも高い周波数感度を 有するコンデンサが得られる。

3 上記半導体本体は、一方の導電型を有する材 本体の両端に現われる電圧降下を減ずるように働 10 料主体中に形成されたとの主体と逆の導電型を有 する拡散領域より成るととを特徴とする特許請求 の範囲第1項の半導体コンデンサ。

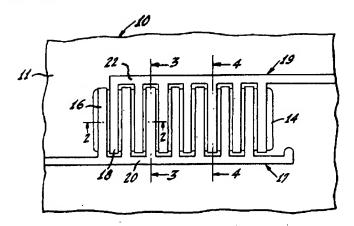
特許請求の範囲

4 上記半導体本体は、基体上に被着された半導 体物質の薄層であることを特徴とする特許請求の 15 範囲第1項の半導体コンデンサ。

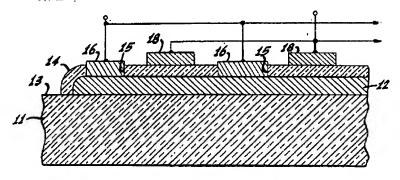
1 半導体物質の本体と、この本体上の絶縁層と、 上記半導体本体に接触する電極と、上記絶縁層上 の極板とから成り、上記電極が上記半導体本体と 接触した複数個の平行を指状突起を有し、上記極

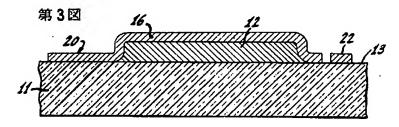
5 上記極板は半導体物質で構成されていること を特徴とする特許請求の範囲第 1項の半導体コン

第1図

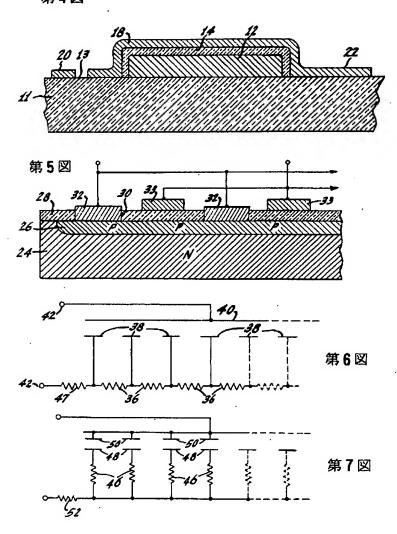


第2図





第4図



4